

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2016-03-008

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本 495,969,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈岚	王渝	

办公地址	深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层	深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层
传真	0755-26051189	0755-26051189
电话	0755-26074462	0755-26074462
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com

## 二、报告期主要业务或产品简介

### （一）公司业务和产品

报告期内，公司的主营业务在三个领域展开：PCB业务、军品业务、集成电路业务。产品及服务广泛应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、计算机应用（PC外设及安防、IC及板卡等）、航空航天、国防军工、半导体等多个行业领域，形成三大业务主线：

#### 1、PCB业务

PCB业务为公司的传统优势业务，提供PCB设计——制造（样板、小批量板）——SMT表面贴装一站式服务模式，流程优化，可实现各环节无缝接驳；凭借在可制造性设计方面的经验积累，有效缩短了客户产品的研发周期，为产品的提前入市提供坚实的后盾，为顾客赢得市场上的先机。PCB产品主要包含刚性板、刚挠板、特种板（金属基板）、HDI板（高密度互联板）等。

#### 2、军品业务

公司建成了高水平的独立军用PCB制造工厂，结合我司PCB设计领域的实力，已为航天、航空、电子科技、兵器工业、船舶重工等数百家军工单位提供产品设计研发及装备制造的一站式服务。2015年12月公司完成收购湖南源科创新科技有限公司70%股权，该公司拥有齐备的军工资质，包括：二级保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书、装备承制单位注册证书等，具备从事军用武器装备存储配套系统科研和生产的条件和资格。源科创新自成立以来就扎根军工业务，拥有丰富的军工产品研制能力和销售能力，其拥有的完备军工资质将大幅提升了上市公司的军品资质等级，至此公司的军品业务将由元器件配套向提供模块级和系统级军工产品领域延伸。

#### 3、集成电路业务

公司集成电路业务主要包括IC载板制造在内的IC封装解决方案以及半导体测试板整体解决方案。

目前公司IC载板已建立良好的客户基础，订单争取较为顺利，可以按客户的需求生产各类基板，包括PBGA、CSP (FBGA)、MCP、PoP、fcCSP、Interposer等。

2015年11月30日，公司取得美国纳斯达克上市公司Xcerra Corporation 半导体测试板相关资产及业务，该业务在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位，其主要客户均为一流半导体公司。使得公司具备该细分行业全球领先的方案设计、制造一站式服务能力。

### （二）公司所处的行业情况和地位

#### 1、PCB行业

从全球PCB市场来看，在经历了之前双位数的增长后，2015年减缓至个位数增长，国内PCB产业年增

长率预计仍维持在个位数的增长。

PCB行业已经是一个技术成熟行业且已步入缓慢增长，市场和利润必然会受到影响；国内持续上涨的生产成本(逐年提升的最低工资标准、电费、水费等)不断侵蚀企业的利润。从产品结构来看，在从高速增长逐步放缓的过程中，中高端的产品在国内本地开始成长，如软板、8-18层和18层以上以及封装基板等，未来微孔板的需求成长率将跑赢其他类型的产品。

PCB行业的下游应用领域较为广泛，受单一行业的影响较小，PCB行业的周期性主要表现为随宏观经济周期的波动而波动；PCB行业的季节性特征亦不明显；PCB批量板通常对交货期要求不高，因此销售的区域性特征不明显。与量产行业相比，PCB样板行业受宏观经济波动的影响相对较小，对交货期要求较高。

公司是国内规模最大的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，为该细分领域的龙头企业，被中国印制电路行业协会连续两届评选为优秀民族品牌企业。

## 2、军品行业

2015年以来，军队改革步伐明显加快，建立联合作战指挥体系，实现各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为海、空装备的快速发展带来机遇，进一步增加对信息化装备需求。随着国家安全战略升级、国防军费开支的增长为公司在军工市场的持续快速发展提供了市场条件。

公司已深耕军品业务多年，目前应用主要集中在航天、航空领域，为客户提供CAD设计+PCB制造相结合的服务，近两年对军品业务资源的投入以及市场开拓力度的加大驱动公司军工业务实现较快增速，但相较于适合公司服务的军工市场，还有广阔的前景。

此外，公司通过收购湖南源科创新公司为军工客户提供高可靠性军用固态硬盘、高安全性固态硬盘、大容量存储阵列以及特种军用固态存储载荷，这一市场规模约为25亿。后续公司将加大对源科创新的投入，导入军工射频及微波组件产品、军用光电信息处理等产品，进一步扩展公司元器件及产品在军品市场广阔的发展空间，将由元器件配套向提供模块级和系统级军工产品领域延伸。确保公司在军品业务上的稳定、持续的高速增长。

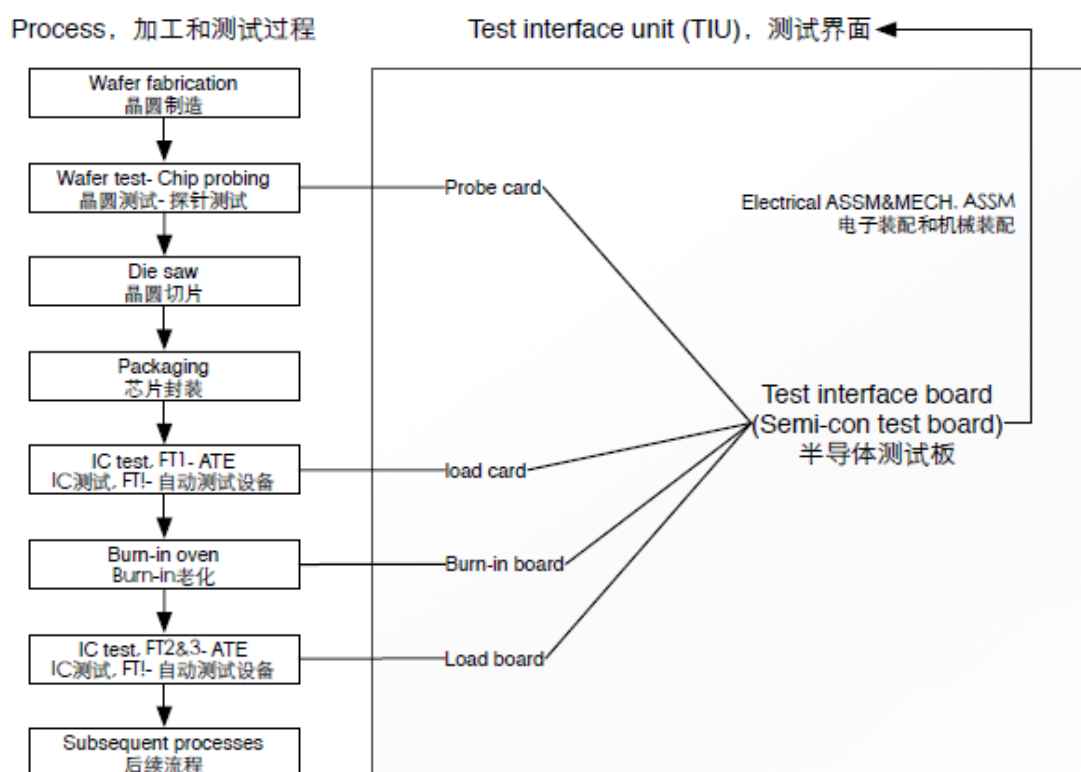
## 3、集成电路行业

随着全球电子信息产业快速发展，全球集成电路市场及封装测试市场得到持续快速发展，计算机与通信已成为全球电子信息产业的主导产品并快速发展，全球电子信息产品设计和制造主要向轻、小、薄便携式发展和多功能系统集成方向发展，使以IC载板为基础的高端集成电路市场及先进封装测试市场得到快速发展并成为发展主流。随着上世纪90年代以来全球电子信息产业快速向中国转移，中国已经成为计算机与通信、消费电子产品制造的中心，全球集成电路产业包括先进集成电路封装测试产业快速向中国转移，加上中国本土集成电路封装测试企业的快速发展，使中国IC载板市场需求日趋旺盛。而IC载板供给方面全球主要集中在日本、台湾和韩国，2010年日本IC载板产值占全球IC载板产值的45%。台湾和韩国等亚洲国家和地区IC载板总产值约占全球IC载板产值的49%。而中国的IC载板产值仅占全球IC载板产值的5.6%，并90%以上由台湾IC载板企业在大陆设厂生产。IC载板属于高端PCB产品，由于IC载板行业技术壁垒、资金壁垒很高，而中国本土PCB企业由于过去十年仍在起步和早期成长阶段，绝大部分从事中低端常规PCB产品的

生产，不具备涉足IC载板行业的条件。目前只有两三家国内领先的PCB企业在开始研发和小批量生产IC载板,因此目前中国本土企业IC载板产量可以忽略不计。而中国大陆持续旺盛的IC载板市场需求与大陆IC载板稀少的供给之间将长期形成巨大的供需缺口。而随着全球IC载板产业逐步向中国转移，加上中国本土IC载板企业的快速发展，以及政府对集成电路制造企业的政策倾斜力度进一步加大，对集成电路企业的支持进一步增加，对于整个集成电路产业以及集成电路制造行业在我国的发展具有积极的作用，必将推动该行业的快速发展。

公司于2012年开始布局该业务，第一期设计年产能为12万平方米。目前尚处于起步阶段，2015年第四季度，单月产出突破3,000平米，初步实现量产能力，达到公司预定的目标。

半导体测试板广泛应用于从晶圆测试到封装前后测试的各流程中：



半导体测试板因为其高层数、高厚径比和小孔距造成加工难度大，同时需要技术、销售团队拥有半导体测试极强的专业知识，以上的原因造成高端半导体测试板全世界只有少数公司可以生产销售，主要分布在美国、日本和韩国，国内公司很少涉足。兴森从2013年起涉足半导体测试板业务，2015年底从美国上市公司Xcerra收购超过20年经验、美国市场排名第一的半导体测试板业务，并重新启用Harbor Electronics这一业界知名品牌。

Harbor Electronics具有世界领先技术以及快速交付等集成优势，可以设计制造高层数（最高达100层），高板厚（12mm），小间距（0.3mm pitch）、高厚径比（31：1）的半导体测试板，分布在中国、美国、欧洲以及东南亚的设计以及服务团队已经为世界各地知名芯片公司提供持续的一站式半导体测试板服务，是全球及国内一流半导体公司重要的合作伙伴。

通过整合Harbor Electronics最高端生产能力和国内低成本生产优势，兴森已具备为全球客户提供全系列的半导体测试板整体解决方案的领先能力，覆盖美国、欧洲及中国的半导体测试专业团队也将大幅度拓展该业务的销售规模。下一步更将加大研发通过IC载板满足半导体测试板间距进一步减小的未来市场需求，保持该业务的持续领先。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	2,119,478,903.82	1,673,825,204.80	26.62%	1,300,797,368.79
归属于上市公司股东的净利润	140,209,675.51	125,722,065.39	11.52%	114,485,406.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,114,268.54	114,911,150.36	-27.67%	108,830,368.83
经营活动产生的现金流量净额	184,968,214.55	157,718,880.62	17.28%	134,740,409.00
基本每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%	0.51
加权平均净资产收益率	6.86%	7.56%	-0.70%	6.99%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,795,192,816.14	2,615,527,739.40	45.10%	2,300,996,204.19
归属于上市公司股东的净资产	2,189,534,962.87	1,713,605,146.89	27.77%	1,623,333,592.77

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	428,108,293.22	578,579,714.19	528,700,698.30	584,090,198.11
归属于上市公司股东的净利润	15,453,239.48	34,638,770.17	64,452,861.27	25,664,804.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,932,937.24	47,391,701.06	14,960,054.47	7,829,575.77
经营活动产生的现金流量净额	-6,549,480.34	-18,192,485.07	70,485,875.80	139,224,304.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	44,960	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	40,558	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股 份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
邱醒亚	境内自然 人	20.49%	101,617,086	76,212,814	质押	88,330,000	
金字星	境内自然 人	7.43%	36,843,492	27,632,618	质押	29,906,600	
大成创新资 本—兴业银 行—兴森资 产管理计划 1 号	其他	4.96%	24,584,584	24,584,584			
大成创新资 本—兴业银 行—深圳市 国能金汇资 产管理有限 公司	其他	4.96%	24,584,584	24,584,584			
晋宁	境内自然 人	4.50%	22,300,976	0			
叶汉斌	境内自然 人	4.32%	21,416,532	0			
柳敏	境外自然 人	3.98%	19,758,348	14,818,760	质押	14,000,000	
张丽冰	境外自然 人	3.19%	15,829,029	0			
刘愚	境外自然 人	2.89%	14,317,804	0	质押	14,000,000	
JPMORGAN CHASE BANK,NATI ONAL ASSOCIATI ON	境外法人	1.32%	6,539,972	0			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东	不适用						

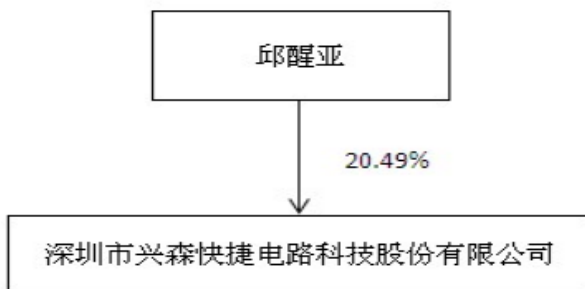
情况说明（如有）	
----------	--

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，全球经济环境仍处在缓慢恢复之中，欧洲经济不稳定持续，而暴恐袭击将更是延迟起未来经济恢复的进程；日本经济依然萎靡不振；唯有美国经济在逐渐恢复。2015年中国经济迎来“新常态”发展的历史性新起点，处于结构转型、人民币贬值、经济增长从高速转向中高速发展阶段，国内外环境错综复杂，经济发展面临不少困难和挑战。我国电子信息产业发展的基本面仍较为良好，但是处于加快转型升级的关键阶段，长期结构性问题、关键技术受制问题与短期困难相互交织，形势较为复杂，提升产业发展质量和效益的任务仍较为艰巨。

报告期内，公司实现营业总收入21.19亿元，同比增长26.62%；归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比增长11.52%；公司实现主营业务收入20.93亿元，同比增长27.30%。报告期内，公司PCB业务同比增长28.24%，主要来自军工、工业控制、半导体细分行业的增长；海外销售收入大幅增长，增幅58.71%，主要是海外参股公司Fineline2015年3月纳入合并范围所致；子公司宜兴硅谷销售收入2.37亿，全年未能实现盈亏平衡，2015年第三季度开始企稳，预计2016年的状况会有较大程度的改善，目前首要任务是持续稳定经营状况，加强成本管控，实现盈利；英国子公司Exception受人工成本偏高、管理层调整等因素影响，2015年度处于亏损状态；IC封装载板业务，因上半年投入增加，在推进量产的过程中，原材料耗用加大，成本上升，上半年亏损处于历史峰值，但随着产品良率和量产能力的不断提升，到2015年第四季度实现量产能力后亏损已逐月减少，预计2016年亏损总额将大幅降低。

2016年，公司将细化管理，继续优化产品结构，提升产能，经营业绩有望迈上一个新的台阶。

报告期内，公司样板的毛利率为35.57%，毛利率水平较去年相比下滑5.36%，小批量板的毛利率为22.94%，毛利率水平较去年相比上升5.37%，总体毛利率水平与去年相比基本持平，主要原因为：行业市场环境严峻，竞争加剧，人工成本上升，导致样板毛利率出现下滑；而小批量板毛利率上升，主要是纳入合并范围的Fineline公司毛利率水平高于公司毛利率水平所致。随着子公司宜兴硅谷的产能逐步释放，以及订单结构的调整、工艺技术的改造、高附加值新产品的导入，公司整体毛利率水平将会稳步提升。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
样板	964,055,731.95	621,184,880.21	35.57%	19.81%	30.67%	-5.36%
小批量	1,036,652,975.52	798,809,139.96	22.94%	37.23%	28.29%	5.37%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。



### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化，新增以下公司纳入本期合并报表范围。

全资子公司：Harbor Electronic Inc、上海泽丰半导体科技有限公司、天津兴森快捷电路科技有限公司

控股子公司：湖南源科创新科技有限公司、Fineline Group、QPI Group

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

邱醒亚

二〇一五年四月十三日